## **OPTICAL DISK AND ITS PRODUCTION**

Patent number:

JP2214041

Publication date:

1990-08-27

Inventor:

YATAKE MASAHIRO

Applicant:

SEIKO EPSON CORP

Classification:

- international:

G11B7/24; G11B7/26

- european: Application number:

JP19890033126 19890213

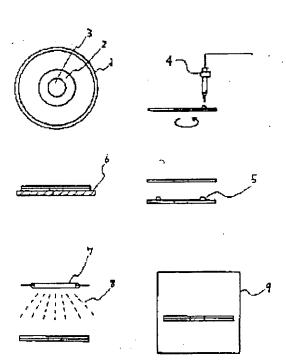
Priority number(s):

JP19890033126 19890213

Report a data error here

### Abstract of JP2214041

PURPOSE:To enhance heat resistance and to prevent overflowing of an adhesive of a thermosetting type to an outside end part by sticking plural plates of optical disk single-plates by using the adhesive and heating the substrates. CONSTITUTION:Two plates of the optical disk single-plates having parts 1, 2 where the recording layers are not formed in the outer peripheral part and inner peripheral part of the substrates are used and the adhesive 5 of the thermosetting type is applied on the side of one of the optical disk single-plates where the recording layer is not formed. This sheet is stuck to another optical disk single-plate and the plates are heated by a heater 6. The stuck optical disk 7 is irradiated with UV rays 8 to cure the adhesive 5 of the part where the recording layer is not formed, by which the disk is tentatively fixed. The disk is then heated in an oven 9 to cure the adhesive 5. The plates are stuck to each other by using the adhesive of the thermosetting type in such a manner, by which the tentative fixing of the disk by light, such as UV rays, is executed and the heat resistance is enhanced. In addition, the overflowing of the adhesive 5 from the outside end part of the disk to impair the appearance of the optical disk is obviated and the optical disk of a both-face type is easily obtd.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-214041

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成2年(1990)8月27日

G 11 B 7/26 7/24

В

8120-5D 8120-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

**2**発明の名称 光ディスク及びその製造方法

②特 願 平1-33126

正 弘

②出 願 平1(1989)2月13日

**@発明者 矢竹** 

( | 1 (1000) 10)11011

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

勿出 願 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

個代 理 人 弁理士 上柳 雅誉 外1名

## 明細音

1. 発明の名称

光ディスク及びその製造方法

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、光ディスク及びその製造方法に

#### いする。

[従来の技術]

従来の光ディスクはホットメルト型の接着 剤を用いたロールコート法、エポキシ機能, 紫外線硬化樹脂などを用いて貼り合わせてい

## [発明が解決しようとする課題]

しかし従来技術では以下のような問題点を付していた。 ロールコート法では接着のの信がないため、高温での光ディスクのお話による貼りで化させるため、加熱は、接着剤がディスクの外観を出たららなれたが、大くの外観を開いたものでは両面型の光ディスクの実現が非常に難しい。

そこで本発明はそのような課題を解決する ものでその目的とするところは以下のような ところにある。 無硬化型の接着剤を用いて貼 り合わせて加熱することにより、 ホットメル ト型の接着剤より耐熱性のある光ディスクになる。 紫外線などの光でディスクを仮止め可能にすることにより、 通常のエポキン機関が を用いて貼り合わせ時にありがちな、 接着剤が ディスクの外端部から遊れ出して光ディスクの外観を 損なうことがない。 しかも 紫外線 化型接着剤では困難な両面型の光ディスクを容易に実現できる。

#### [課題を解決するための手段]

その例としては、 2 ーエテルー 4 メ チルイミダソール、 1 ーベンジルー 2 ーメ チルイミダソール、 1 ーイソブチルー 2 ーメ チルイミダソール等のイミダソール系、 メンタンジアミン等の環状脂肪族アミンなどがある。

紫外線硬化樹脂の主剤としては常温で比較 的低粘度のものがよく、しかも反応性の高い ものをもちいるとよく、その例としては1、 6 ー ヘキサンジオールジアクリレート、トリ メチロールプロパントリアクリレート。ネオ ペンチルグリコールジアクリレート、ジペン タエリスルトールへキサアクリレート等がある のでこれらを主成分にするとよい。

紫外線硬化製脂の硬化剤の例としては300mmより長い波長に吸収があるものを用いる。 その例としてはペンジルジメチルケタール, 1-ヒドロキンシクロヘキシルフェニルケトン, 2-メチルー [4-(メチルチオ)フェニル] -2-モルフォリノー1-ブロバ

クを加熱して前途の接着剤を硬化する手段と によって作製されたことを特徴とする。

本発明に於て接着剤には少なくともエポキシの主剤及び硬化剤、紫外線硬化樹脂の主剤及び硬化剤の混合物に有線過酸化物を添加したものを用いるとよい。

エポキシの主剤の例としては、 ビスフェノール A 系、ビスフェノルF系、ノポラッカ系等に、 低粘度 エポキシである反応性希釈剤を を加したり、 添加しなかったりするものを 伊 が あとよい。 反応性希釈剤の含有量が多くなる なるが、 接着層の特性が悪くなので添加量は ひかえた方がよい。

ェポキシの硬化剤としては酸無水物、芳香族アミン、脂肪族アミン、アミド等あるが、その中でポットライフが常温で 1 から 5 0 時間にあるものを用いるとよく、40℃から 8 o ℃で硬化できる硬化剤を選択するとよい。

ノン、ペンソイン、ペンソンエチルエーテル、 ペンソインイソブチルエーテル。 1 - (4 - イソプロピルフェニル) - 2 - ヒドロキシー 2 - メチルプロペン-1 - オン、 2 - ヒドロキシーキシー2 - メチルー1 - フェニルプロペンー 1 - オン、3、3 - ジメンルー4 - メトキシペンゾフェノン等が挙げられる。

5、 5 - トリメチルヘキサノイルパーオキシ ド, オクタノイルパーオキシド, デカノイル パーオキシド, ラウロイルパーオキシド, ク ミルパーオキシオクトエート, サクシン酸パ ーオキシド, アセチルパーオキシド, tーブ チルパーオキシ(2-エチルヘキサノエート) , m-トルイルパーオキシド, ベンソイルパ ーオキシド。 ヒープチルパーオキシイソプチ レート、 1、 1 - ピス(ヒープチルパーオキ シ) 3, 3, 5ートリメチルシクロヘキサン。 1, 1-ヒス(ヒーブチルパーオキシ)シク ロヘキサン, ヒープチルパーオキシマレイン 敢。 ヒープチルパーオキシラウレート、 ヒー プチルパーオキシ3、 5、 5ートリメテルへ キサノエート, シクロヘキサノンパーオキシ ド。 ヒープチルパーオキシアリルカーボネー ト、 t - プチルパーオキシイソプロビルカー . ポネート。 2、 5 ー ジメチルー 2、 5 ー ジ( ベンソイルパーオキシ) ヘキサン, 2, 2 -ヒス ( t ー ブチルパーオキシ) オクタン, t

本発明に於て、貼り合わせを減圧下で行な うと接着剤の脱泡も容易になり、接着層に気 泡を取り込みにくくなる。

## [実施例]

以下本発明について図面に基づいて詳細に説明する。

第1図(8)から第1図(1)は本発明になる光ディスクの製造方法の概略図である。 1は基板の外周部の記録層が成膜されない部分、2は基板の内周部の記録層が成膜されない部分、3はディスクのセンターホール部、4はディスペンサー、5はリング状に整布された接着層、6はヒーター、7はメタルハライドランブ、8は紫外線、9はオーブンである。

 ープチルパーオキシアセテート, 2, 2ーピ ス (tープチルパーオキシ) プタン, tーブ チルパーオキシペンソエート等が挙げられる。

本発明において、貼り合わせ時の温度は接着剤の粘度により変える必要があり、常温を り高くすることが好ましいが、定状温度を やすくするため、70℃以下にすることが好ましいが、 ましい。より好ましくは40℃から60℃で まる。接着剤を硬化させるための基板加熱は 接着剤の硬化温度に合わせて、40℃から8 0℃が好ましい。より好ましくは50℃から 70℃である。

本発明に於て、エポキシと紫外線硬化樹脂の配合割合はエポキシ樹脂の配合割合が多い方が接着剤としての特性がよく、エポキシと紫外線硬化樹脂の比が重量比で95:5から70:30が好ましい。ここでエポキシとはエポキシの主剤と硬化剤のことを示し、紫外線硬化樹脂とは紫外線硬化樹脂の主剤と硬化剤に有機過酸化物を添加したものを示す。

2 及び 1 8 は T b F e C o 層, 1 3 及び 1 9 はSIAIN層, 14及び20はA1層, 1 5 は接着層, 2 1 及び2 2 はハードコート層 である。 10及び16のポリカーボネートの 養板は射出圧箱成形によって形成した。 1 1 及び17のSiAiN層はSiA1の焼結タ ーゲットを用いて、窒素とアルゴンの混合ガ スを用いることによるRF反応マグネトロン スパッタ法によって成膜したものである。 1 2 及び 1 8 の T b F e C o 層は T b F e C o の合金ターゲットを用いたDCマグネトロン スパッタ法によって成膜したものである。 1 3 及び1 9 の S I A 1 N 層は 1 1 及び 1 7 の SIAIN層と同様に、窒素とアルゴンの混 合ガスを導入することによるR.F反応マグネ トロンスパッタ法によって成膜したものであ る。 1 4 及び 2 0 の A 1 層は A 1 の ターゲッ トを用いてアルゴンガスを導入することによ るDCマグネトロンスパッタ法によって成膜 したものである。15の接着層は大日本イン

+ 化学工業のエピクロンS-129と油化シ ェルエポキシのエピキュアーIBMI-12 と 1、 6 - ヘ キ サ ン ジオ ー ル ジ ア ク リ レ ー ト とt-プチルパーオキシイソブチレートとチ パガイギー社製のイルガキュアー907の混 合物を, 記録層が成膜された側にリング状の 塗布した後、 真空系内で別の基板と合わせて, その貼り合わせた基板をホットプレート上に 乗せて接着剤を広げて、メタルハライドラン プで紫外線を照射して、 記録層が成膜されて いない部分の接着剤を仮硬化させて, それか ら50℃で3時間60℃で8時間加熱して接 着層を硬化させた。21及び22のハードコ ート層はトリメチロールプロパントリアクリ レートと 1、 6-ヘキサンジオールジアクリ レートとチバガイギー社製のイルガキュアー 9 0 7 の混合物を基板表面にスピンコートし た後、高圧水銀灯により紫外線を照射して硬 化させたものである。

次に、 従来の方法で光ディスクを作成した

に応力がかかり再生信号のエンベローブが乱れ、エラーが増加した。 以上の様に従来の方法で作成した光ディスクは耐候性が弱かったり、作成方法が難しく歩留りが低い等の問題点を有している。 しかし、本発明では従来が容易な光ディスクであることがわかる。

尚, 本発明はこれらの実施例に限定されると考えられるべきではなく, 本発明の主旨を 逸脱しない限り種々の変更は可能である。 「発明の効果」

以上述べたように本発明の光ディスクを対するというに本発明の光ででの接着対象を用いて貼り合わせて加熱することでのまたでは、対象等の光でディスクで、業外線等の光でディスクを仮としたのの外線等の光ででのままた、接着対の外線ではなったとがなく、しかも無外線である。

例について説明する。 ロールコート 法で貼り 合わせた光ディスクは、 70℃90%RHで 1000時間耐候性試験したところ。 記録層 が酸化してビットエラーレートが増大した。 本発明になる第2図に示す光ディスクも同時 に試験したがピットエラーレートの変化はな かった。通常のエポキシ樹脂を用いて貼り合 わせた光ディスクは貼り合わせ時の粘度が高 かったため接着層が厚めになり。 面 振れ量が 本発明になる第2図に示す光ディスクより大 きくなった。 通常のエポキシ樹脂を用いたも のが最大フミリラジアン。第2図に示す光デ ィスクが最大2ミリラジアンであった。 また, 通常のエポキシ樹脂を用いて貼り合わせた光 ディスクでは、接着剤硬化時にディスクの外 周から溢れ出して光ディスクの概観を損なっ た。接着剤が熱で硬化するタイプでは温度制 御が難しく, 基板が接着層硬化時に動かない ようにしておく必要があり、常温硬化型の接 着剤で貼り合わせると接着層硬化時 に記録層

硬化型接替剤では困難な両面型の光ディスク を容易に実現できるという効果を育する。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図(8)から第1図(f)は本発明になる光ディスクの製造方法の概略図、第2図は本発明になる光記録媒体の基本構成図であ

1 ・・・・・ 基板の外周部の記録層が成膜されない部分

2 ・・・・・基板の内周部の記録層が成膜されない部分

3 . . . . . . ディスクのセンターホール部

4...・・・ディスペンサー

5 ・・・・・・リング状に堕布された接着層

8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 - ・・・・メタルハライドランプ

8・・・・・・紫外線

10, 16・・ポリカーポネートの基板

11. 17··SIAINの保護層

12. 18··NdDyFeCoの記録暦

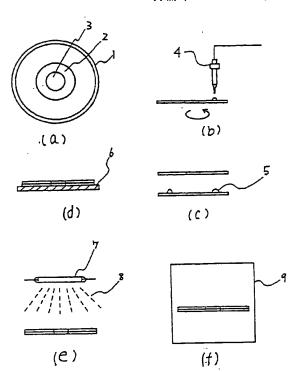
13. 19··SIAINの保護層

14. 15 · · A 1 /2

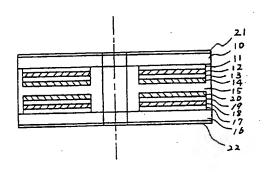
15・・・・・接着層

2 1. 2 2 ・・ハードコート層

以上 出願人 セイコーエブソン株式会社 代理人弁理士 上郷雅誉 (他1名)



第 1 図



第 2 図